

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	2026年4月9日 公开业绩说明会
时间	2026年4月9日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长、首席执行官、总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智

	<p>能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。</p> <p>为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。</p> <p>基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。</p> <p>2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：公司 4 月 1 日正式向港交所递交 H 股上市申请，港股上市目前进展到哪个阶段？</p> <p>回复：公司已于 2026 年 4 月 1 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，截至目前，各项上市筹备工作正平稳有序推进中，公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施。关于港股上市的进展请关注后续刊</p>

载在香港联交所网站的相关信息。

问题：随着推理需求爆发、大厂自研 ASIC 趋势加剧，行业竞争日趋激烈，请问公司能否维持较高的定价水平与利润率？

回复：近年来，系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，已成为系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之一。2025 年，芯原系统级客户（非芯片设计公司）所产生的收入占比约 40%，且连续 5 年保持在 30%以上。随着公司一站式芯片定制能力提升，为客户带来更高价值，公司参与度及附加值更高客户项目收入占比增加，带动公司议价能力等核心竞争力的提升，将有利于盈利能力的提升。

问题：公司在端侧 AI 领域与谷歌的合作目前有无最新进展？应如何判断端侧 AI 应用走向繁荣的拐点？

回复：针对快速发展的 AI 端侧应用，芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP；其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为智能眼镜、可穿戴设备、AI 玩具等提供“轻量级、始终在线、超低能耗”的端侧 AI 解决方案。

基于上述端侧 AI 布局与行业发展趋势，公司认为，判断端侧应用走向繁荣的拐点的核心标志是实现从“技术可行”到“商业规模化”的跨越。这通常体现在三个维度：在技术层面，轻量化模型与专用低功耗芯片（AI

ASIC)的成熟,使得复杂 AI 能力能在终端高效运行;在产品层面,出现了真正解决用户痛点且销量爆发的重要应用或硬件(如 AI 手机、智能眼镜),并形成了感知、计算、决策的完整智能闭环;在产业链层面,则表现为上游芯片设计订单的激增以及下游各类产品和服务提供方的全面入局与生态构建。为此,芯原在持续夯实云端 AI ASIC 技术根基的同时,正不断优化和扩展面向端侧 AI ASIC 的解决方案平台,包括存量的 AI 手机、AI PC、AI Pad,以及增量的 AI 眼镜、AI 玩具、AI 戒指和智慧出行等市场,以公司自有的丰富 IP 组合与一站式芯片定制服务,全面赋能端侧 AI 硬件的规模化量产。

问题:面对全球半导体产能波动、晶圆代工价格调整、供应链地缘政治等挑战,公司与头部的晶圆代工的合作模式、产能保障、成本控制机制是怎样的?

回复:公司采用晶圆厂中立策略,供应链管理灵活且抗风险能力强,具体主要表现在:①芯原对晶圆厂中立的策略,使得芯原可以和全球所有主流的晶圆厂合作,不受限于某一家公司的发展情况;②公司与大多数晶圆厂拥有超过 10 年或 15 年的长期合作关系,共同发展,保持了良好的沟通;③在长期合作中,芯原建立了良好的商业信誉,供应商会按历史合作数据预留产能,保障供给;④公司可以通过打包的方式拿到产能,有自己的资源池,通过内部资源再分配,对中小型规模的客户友好;⑤不同生产工艺的产能短缺时间和程度不一样,因芯原客户多样化,可以做一定的调整 and 平衡。

问题:公司 2025 年 IP 业务、芯片设计服务、半导体 IP 授权三大核心板块的营收占比、毛利率出现了哪些结构性变化?

回复:公司 2025 年度实现营业收入 31.52 亿元,较 2024 年度增长 35.77%。按业务构成划分,在半导体 IP 授权业务领域,公司实现知识产

权授权使用费收入 6.71 亿元，同比增长 6.07%；实现特许权使用费收入 1.11 亿元，同比增长 7.57%。在一站式芯片定制业务领域，公司实现芯片设计业务收入 8.77 亿元，同比增长 20.94%；实现量产业务收入 14.90 亿元，同比增长 73.98%。2025 年度，公司实现毛利 10.78 亿元，同比提升 16.43%。公司 2025 年度综合毛利率 34.19%，较上年同期下降 5.68 个百分点，主要由于收入结构变化等因素导致。公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体 IP 授权服务业务较低，但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。